

BCC Resins HPX-850

Epoxy; Epoxide

BCC Products Inc.

Описание материалов:

HPX-850 is a light weight, heat resistant, two component epoxy backfill system. Like BC 7020, the filler portion is pre-blended into the resin and hardener components for easier handling, thus simplifying the mixing process. HPX-850 features advantages such as low cost, long pot life, machineability, and low shrinkage. It is ideally suited for numerous applications involving mold and core constructions.

HPX-850 can be removed from the mold after allowing to set 24 hours @ room temperature (75°F). Post cure for applications requiring temperatures above 150°F can be accomplished in an oven or in use by a gradual heat rise; 2 hours @ 150°F, plus 2 hours @ 250°F, plus 2 hours at 300°F.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая термостойкость Низкая усадка Обработываемый		
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Серый		
Формы	Паста		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.818	g/cm ³	ASTM D792
--	0.830	g/cm ³	ASTM D1505
Формовочная усадка-Поток	0.020	%	ASTM D955
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	141	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Weight: 6.0		
Срок службы горшка (24°C)	120 to 150	min	
Время демолд	1400	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

